

# 测试题

## 一、选择题 (2\*10)

- 与传统的通孔插装产品相比较, SMT 产品具有( )的特点:  
A. 轻            B. 长            C. 薄            D. 短            E. 小
- 表面组装元器件的包装类型有:( )  
A. 散装    B. 管装    C. 编带    D. 托盘
- 高速机可贴装哪些元器件:( )  
A. 电阻    B. 电容    C. IC        D. 晶体管
- 以下哪些是电阻的作用 ( )  
A、分压            B、降压            C、分流、限流    D、以上都是
- 以下哪些是电感的作用 ( )  
A、分压            B、降压            C、分流、限流    D、以上都不是
- 表面丝印为“472”的电阻实际阻值是多少 ( )  
A、470 欧姆        B、47.2 欧姆        C、4700 欧姆        D、47 欧姆
- 色环电阻有效数字 (0-9) 表顺序依次是 ( )  
A、棕红橙黄蓝绿紫灰白黑            B、黑棕红橙黄绿蓝紫灰白  
C、黑白棕红橙黄蓝绿紫灰            D、棕红橙黄蓝绿紫灰黑白
- 五环电阻本体颜色是“棕、黄、黑、黑、棕”的实际阻值是多少 ( )  
A、141 欧姆        B、140 欧姆        C、1400 欧姆        D、14 千欧姆
- 锡膏的组成:( )  
A. 锡合金粉+助焊剂            B. 锡合金粉+松香    C. 锡粉+稀释剂    D. 锡条+松香
- 未开封的锡膏在使用前一般回温时间为多长时间 ( )  
A、2H            B、1H            C、4H            D、3H

## 二、填空题 (2\*10)

- 锡膏在使用前, 须经过两个重要的过程\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_;
- $0.1\mu\text{H} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mF}$ 、 $1\text{nF} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ uF}$
- BGA 的中文全称: \_\_\_\_\_、 四边引脚扁平封装英文简称: \_\_\_\_\_。
- 锡膏的重要特性: \_\_\_\_\_。
- SMT 表面组装单面锡膏工艺流程顺序: \_\_\_\_\_。
- SMT 的优点: \_\_\_\_\_。
- 对以下单位进行换算  
 $100\Omega = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}\Omega = \underline{\hspace{2cm}} \text{ K}\Omega$        $5600\text{nH} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ uH} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mH}$
- 0402 的电子物料尺寸为: \_\_\_\_\_      0201 电子物料尺寸: \_\_\_\_\_。
- 电阻表面字符 4R45 电阻值为: \_\_\_\_\_,    62m6 电阻值为: \_\_\_\_\_。
- 305 无铅焊料锡膏百分比例分别是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

## 三、简答题 (60)

- 表面组装技术的一般线体布局包含哪些? (8)

2、SMT 相关术语. SMT, SMD, SMC, PCBA, 的中文全称 ? (8)

5、锡膏在什么环境下使用最好, 它的存储要求 ? (10)

3、 SMT 中使用的元器件有哪些要求? (10)

6、请写出表面组装工艺技术的组成。(12)

4、SMT 中双面工艺有几种? 分别是哪些? 并写出工艺顺序。(12)